







效率:专为实现高性能、高灵活性目标而设计

快速换线

- UPH: 1300

可靠性生产目标

- 可安装1-6 个FlashCORE Ⅲ 烧录 激光打标 器 (4-24 个烧录座)
- 可安装1-5个 LumenX 烧录器 (1-40 个烧录座)
- 自动化升级的理想选择

灵活配置

- 集成化选配系统
- 小尺寸芯片支持: 2mm x 3mm
- 大尺寸芯片支持: 42.5 mm x

42.5mm

最优化算法支持

- FlashCORE III已实现全器件支持
- 搭载TurboBoost技术的LumenX 烧录器可实现超快速eMMC和 UFS芯片烧录
- 搭载VerifyBoost技术的LumenX 烧录器提升了4.5倍的读取速度

可靠: 专为实现最高烧录质量、最高烧录良率目标而设计

最高烧录质量

- 高性能适配器 (HIC)
- 高附加值软件

智能化系统设计和集成

- 行业领先的烧录器、处理技 术及软件系统

集成化视觉系统实现精准定位

- +/-30微米, 可重复精确放置
- 支持小尺寸芯片

性价比:专为实现低烧录总成本目标而设计

最低总成本

- 显著降低生产人力成本
- 每片芯片节约3倍成本
- 最大的插座密度使其所占空间 最小并可随产量快速扩展容量

投资保护

- 充分利用已购买的 FlashCORE & LumenX 适配器 及算法
- LumenX持续支持新的芯片 技术以确保您的投入始终受 到保护

全球服务支持

- 本地化服务支持
- 本地备件库

DATA I/O 中国

- 上海市徐汇区平福路188号3号楼6楼
- www.dataio.cn
- ChinaSales@dataio.com
- 021-58867686

处理系统

• 取放装置:

产能:

每小时1300 片 ± .02mm

放置精度:

使用步进电机控制上下运动, 伺服电机控制旋

转的单吸取头

Z轴最大行程:

50mm (最大)

• 定位方式: • 执行标准:

Upward looking camera CE Compliant, RoHs, WEE • 运输尺寸:

系统软件:

• 框架尺寸:

TaskLink for Windows, CH700, Windows 10 1290mm D x 870mm W x 1520mm H

(不包括选配系统)

1310mm D x 930mm W x 1760mm H

(不包括选配系统)

• 净重: 450kg (992 lbs) • 运输重量: 550kg (1212 lbs)

输入/输出选配系统

· Tape Input:

8mm - 56mm

· Tape Output: · Tray Feeder

8mm - 44mm (可调节) 支持安装20个 JEDEC Tray盘

Input/Output: Manual Tray:

不需要使用特殊工具

• Tube Input/Output

· Reject Bin

增值软件

Serial Number Server

· Automotive Performance PAK

· NAND Flash Bad Block Management

· Command Line Interface (LumenX)

ConneX® 智能烧录软件

• LumenX Software包括: 2.0及更高版本的TurboBoost标准 VerifyBoost许可证

芯片打标系统选配

• 激光打标: • 墨点打标: 光纤激光打标

功率:

0 - 10 W

最小可支持打标范围为4mm x 4mm

其他选配

• 视觉:

• 静电消除器: • 条码扫描仪

2D 带装出料检测

可安装3个静电消除器

烧录器, 适配器 & 算法支持

烧录器:

- FlashCORE III
- 搭载TurboBoost和VerifyBoost的LumenX® 烧录器

烧录座技术:

- Standard burn-in socket (每个烧录座使用次数为5,000 10,000次)
- High Insertion Count Socket (HIC) 适用BGA, TSOP, QFP (每个烧录座使 用次数为250,000次)

封装支持:

PLCC, SOIC, SON, WSON, SSOP, CSP, BGA, uBGA, FPGA, QFP, TQFP, TSOP, PoP, DIP 等

算法支持:

- FlashCORE III 支持Flash Memory (NOR, NAND, MCP, MMC, e.MMC, SD, MoviNAND, OneNAND, iNAND, Serial Flash, EEPROM, EPROM等), Microcontrollers及Logic芯片 (CPLD, FPGA's, PLD's) 等,
- 搭载TurboBoost 技术的LumenX®支持eMMC, UFS, SD, SPI NOR, Secure Elements, Secure Microcontrollers 等

芯片烧录和测试:

Program, continuity, checksum, blank check, mis-insertion, test, verify, backwards device, two pass verify, ID check, Illegal bit-check

服务支持

- PSV5000 基本配件包
- · PSV5000 补充配件包
- FlashCORE III 配件包
- 操作员培训
- 延长服务合同:系统价格已包含第一年服务支持的费用。Data I/O 同时为用户提供延长服务及涵盖软件及硬件的服务支持包(不包括消 耗品)

规格要求

• 输入电压:

208-240 VAC, 50/60 Hz, 1 PHz

10 Amps Max

• 操作环境温度:

55°F to 86°F (+13°C to + 30°C)

• 湿度:

35% ~90% RH 无凝结 80psi (5.5 bar)

气压:

气流:

6 SCFM (最大)



